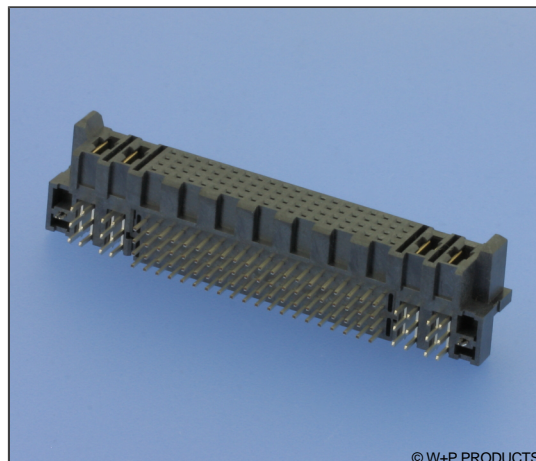


Power-Signal-Terminal RM 5,00/2,00mm, Buchsenkontakte, gewinkelt Power-Terminal 5.00mm Pitch, Female, Right-angled

Technische Daten / Technical Data

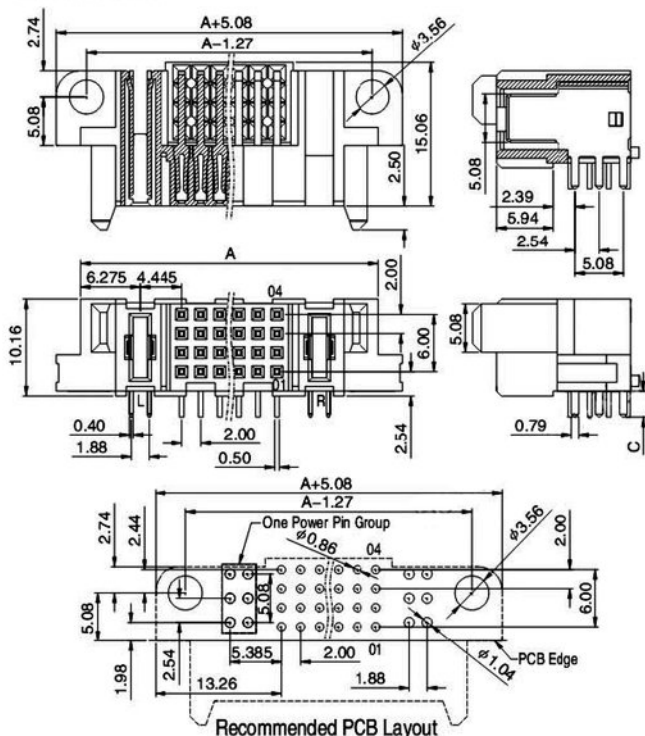
Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to plating options, over Ni
Nennspannung	Power: 600 V AC / 848 V DC
	Signal: 300 V AC / 424 V DC
Voltage Rating	Power: 600 V AC / 848 V DC
	Signal: 300 V AC / 424 V DC
Nennstrom	Power: 24,7 A / Signal: 1 A
Current Rating	Power: 24.7 A / Signal: 1 A
Temperaturbereich	-55° ... +105° C
Temperature Range	-55° ... +105° C
Verarbeitung	260°C für 10s
Processing	260°C for 10s



© W+P PRODUCTS

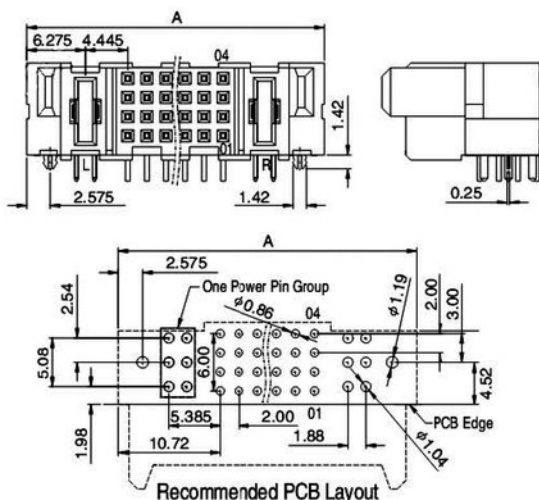
inectors :
7 (24/80)

W/Screw Down



W/Locking Clip

Power Pins/End	A	
	24 Signal Pins	80 Signal Pins
01	31.44	59.44
02	41.44	69.44



Series	Power C.*	Signal C.*	Power C.*	Terminals*	Plating P.C.*	Plating S.C.*	Loc. Opt.*	Packaging*
456	01	80	01	21	00	00	20	ST
	01 02 Contacts Left	24	01 02 Contacts	20 C=2.72mm	00 Au flash	00 Au flash	20 Locking Clips	ST
		80 Contacts	Right	21 C=3.52mm	50 Sn	50 Sn	30 Screw down	TRAY
				22 C=4.32mm	60 Sel. Au/Sn	60 Sel. Au/Sn		
					610 Sel. Au 10µ"/	610 Sel. Au 10µ"/		
					Sn	Sn		

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes
TRAY Auf Tray / On tray

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

